

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2024-063

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）等有关规定，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）将 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额，资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3024 号）核准，公司公开发行 244,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 2,440,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计验资费用、资信评级费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 52,839,000.00 元（含税），实际募集资金为人民币 2,387,161,000.00 元。本次募集资金已于 2021 年 1 月 4 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于 2021 年 1 月 5 日出具了《验资报告》（信会师报字〔2021〕第 ZA10003 号）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金投入募集项目 2,042,160,094.13 元，其中以前年度使用金额 2,017,024,217.06 元，本年度使用金额 25,135,877.07 元，均投入募集资金投资项目，募集资金专户余额为 377,347,095.52 元。

（二）2024 年半年度募集资金使用情况

单位：人民币元

募集资金账户情况	金额
1、募集资金账户期初余额：	399,377,988.43
2、募集资金账户资金的增加项：	3,106,334.16
利息收入	3,106,334.16
3、募集资金账户资金的减少项：	25,137,227.07
募集资金投入募集项目	25,135,877.07
支付银行手续费	1,350.00
4、募集资金账户期末余额：	377,347,095.52

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律、法规，并结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储。

公司与中国民生银行股份有限公司上海分行、平安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与招商银行股份有限公司上海分行、平安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及公司子公司豪威半导体(上海)有限责任公司、兴业银行股份有限公司上海嘉定支行、平安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及公司子公司豪威科技（上海）有限公司、公司子公司 OmniVision Technologies, Inc.、平安银行股份有限公司上海分行、平安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。

公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》《募集资金专户存储五方监管协议》与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专项账户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金专项账户余额为 377,347,095.52 元。

单位：人民币元

序号	账户名称	开户银行	账号	余额
1	上海韦尔半导体股份有限公司	招商银行股份有限公司上海张江支行	121908236710307	861,705.91
2	上海韦尔半导体股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	632634897	已销户
3	上海韦尔半导体股份有限公司	平安银行股份有限公司上海分行	15006188888809	396,397.44
4	豪威半导体（上海）有限责任公司	兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	216130100100280966	已销户
5	豪威半导体（上海）有限责任公司	兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	216130100100307182	已销户
6	豪威半导体（上海）有限责任公司	兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	216130100100307203	已销户
7	豪威半导体（上海）有限责任公司	兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	216130100100307312	已销户
8	豪威科技（上海）有限公司	平安银行股份有限公司上海分行	15119618888860	1.00
9	OmniVision Technologies, Inc.	平安银行股份有限公司上海分行	FTN15555788816865	376,088,991.17
合计				377,347,095.52

三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金人民币 25,135,877.07 元，具体情况详见附表 1《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公开发行可转换公司债券募集资金不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建设项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建设项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，由于公司“CMOS 图像传感器研发升级项目”于 2024 年 3 月实施完毕并达到预定可使用状态，公司决定对该项目结项，并将该项目节余募集资金 37,457.51 万元用于“晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在使用募集资金的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）和《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、其他发行事项

（一）全球存托凭证（以下简称“GDR”）发行情况

公司就本次 GDR 发行获得中国证监会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可[2022]2922 号）核准，并经瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG）的附条件批准，同意公司发行的 GDR 在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市；并就本次发行的 GDR 招股说明书取得了瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室（Prospectus Office）批准。

本次发行的 GDR 已于 2023 年 11 月 10 日（中欧时间）正式在瑞士证券交易所上市，GDR 证券全称：Will Semiconductor Co., Ltd. Shanghai，GDR 上市代码：WILL，本次发行 GDR 数量为 31,000,000 份，其中每份 GDR 代表 1 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票数量为 31,000,000 股。其对应的境内新增基础证券 A 股股票已于 2023 年 11 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记存管，持有人为公司 GDR 存托人 Citibank, National Association（花旗银行）。

（二）GDR 募集资金使用情况本次募集资金总额约为 4.45 亿美元，扣除承销相关费用后实际到账约为 4.37 亿美元，截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金账户余额约为人民币 28.06 万元。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日

附表 1:

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

编制单位: 上海韦尔半导体股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				238,716.10		本年度投入募集资金总额				2,513.59			
变更用途的募集资金总额				111,558.46		已累计投入募集资金总额				204,216.01			
变更用途的募集资金总额比例				46.73%									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
晶圆测试及晶圆重构生产线项目 (二期)	有	130,000.00	18,441.54	18,441.54	0.00	18,508.33	66.79	100.36	2022 年 10 月	740.25	注 1	否	
CMOS 图像传感器研发升级	无	80,000.00	80,000.00	80,000.00	2,513.59	43,830.43	-36,169.57	54.79	2024 年 3 月	6,448.40	是	否	
补充流动资金	无	28,716.10	28,716.10	28,716.10	0.00	28,716.10	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目	有	0.00	83,482.95	83,482.95	0.00	84,024.21	541.26	100.65	2024 年 12 月	不适用	不适用	否	
高性能图像传感器芯片测试扩产项目	有	0.00	20,899.15	20,899.15	0.00	20,960.43	61.28	100.29	2023 年 1 月	397.37	注 2	否	
硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目	有	0.00	7,316.53	7,316.53	0.00	8,176.51	859.98	111.75	2023 年 8 月	361.70	注 3	否	
合计	/	238,716.10	238,856.27	238,856.27	2,513.59	204,216.01	-34,640.26	85.50	/	/	/	/	
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)								不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明								不适用					
募集资金投资项目先期投入及置换情况								不适用					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								不适用					
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况								不适用					
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况								不适用					

募集资金结余的金额及形成原因	不适用
节余募集资金其他使用情况	不适用

注 1：受行业宏观因素以及下游细分终端市场需求不及预期等因素的影响，报告期内，公司控制了晶圆投产量，相应的相较原规划公司减少了晶圆测试及重构业务的规模，导致在报告期内晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）未达到预计效益。

注 2：受行业宏观因素以及下游细分终端市场需求不及预期等因素的影响，报告期内，公司控制了晶圆投产量，相应的相较原规划公司减少了高性能图像传感器芯片测试数量，导致在报告期内硅高性能图像传感器芯片测试扩产项目未达到预计效益。

注 3：受行业宏观因素以及下游细分终端市场需求不及预期等因素的影响，报告期内，相较原规划公司减少了硅基液晶投影显示芯片的投产量，导致在报告期内硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目未达到预计效益。